

PUB. NO.: 54-095183 [JP 54095183 A]  
PUBLISHED: July 27, 1979 (19790727)  
INVENTOR(s): ODATE MITSUO  
APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)  
APPL NO.: 53-003125 [JP 783125]  
FILED: January 13, 1978 (19780113)  
INTL CLASS: [2] H01L-025/10  
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)  
JOURNAL: Section E, Section No. 141, Vol. 03, No. 117, Pg. 127.  
September 29, 1979 (19790929)

ABSTRACT

PURPOSE: To reduce the distortion applied to an element when an electrode is brought into contact with the element by pressure, by interposing a powder metallic layer with a particle diameter below 2.mu.m.

CONSTITUTION: A powder layer 7 with approximately 0.5 mm thickness is generated on the capacity bottom face of base electrode 2 and case 3. Element 1 is put on layer 7 so that electrode 13b may be at the top. Insulating ring 5 is inserted to leading-out electrode 4, and plate spring 6 is inserted. After that, the pressure over three times as large as the spring force of plate spring 6 is applied to solidify layer 7; and after the plate spring is fixed by a protrusion, a device is completed by welding and connection. In this structure, since powder layer 7 becomes a pressure buffering materials and the warp of element 1 is not reformed, element 1 is prevented from being affected by the distortion to a Si substrate and cracking. The thermal resistance and forward voltage drop are reduced.

BEST AVAILABLE COPY

もしくは、リコッキンのセリフによると、リコッキンの月の頭から立候をくすることにエリソ  
が誕生していた。辰巳半導は蒸子の電気特性を改  
善するためにはリコッキン版と支村の名々の材料  
の月の頭から立候をくすることにエリソ  
リコッキン版のストレスを緩和することができるが、  
立候をくすとリコッキン版に対するセリフを増  
長することになる。したがつて、コロウに立候  
をくしたばゆで卯年は蒸子と立候にて庄  
屋力を加えてこれらを立候保有すると、舟にシリ  
コッキン版のセリフを讀むことになるから、逆にシリ  
コッキン版へのメチャクダが増大し、シリコッキン版  
にタクタクが生じたりするといい問題があつた。  
本見明行このような点で見てなされたもので、  
セセの目的とするところは卯年は蒸子に加わるスト  
レシを感知せることにより半導は蒸子をタクタ  
クから保有することができるか立候が半導は蒸  
子を提供することである。

⑨日本国特許庁(JP) ①特許出願公開  
⑩公開特許公報 (A) 昭54-95183  
識別記号 ②日本分類 昭和54年(1979) 7月27日  
99(3) C 21 斎内整理番号 ③公開  
H 01 L 25/10 6741-5F

(全3面)

④ 加压接触半導体装置	出頭人	電機株式会社伊丹製作所内 三菱電機株式会社 東京都千代田区九の内二丁目2番3号
⑤ 特願昭53-3125	出頭人	井代里人 并理士 石野信一 外1名
⑥ 出願昭53(1978)1月13日 者大曾根	出頭人	伊丹市路原4丁目1番地 三菱
⑦ 余明者	出頭人	

卷之三

兎の名前

卷之三

本研究は中等生女子の両耳屈に王室屈とセレゼー  
ー屈で、馬出力の加算筋肉筋中等屈筋度において  
一概に、馬出力の加算筋肉筋中等屈筋度において  
は、中等生女子と王室屈（ベーハ屈屈）の筋  
筋度が、筋筋度と小さくなる必要がある。  
筋筋度、これまでの研究結果からすると手筋として  
握りしむのが用いられているがしかし、前記シ  
リコン筋と支持筋とをハンドルバーを用いて握  
付かじびき金骨合を行なう場合組ハンドルバー  
は初期筋度が大きいがシリコン筋と支持筋との間  
筋筋度に及んで前記組合時シリコン筋の筋  
筋度にストレスが現り、それが半筋子の筋筋  
筋度を害するせり、或は各筋群の筋筋度を  
過度にもたらす原因にシリコン筋が大

る所からなる引出し裏板、(5)ハイカ版などの地  
板、(6)ハイカ版よりなる皿等。(7)は前  
述の如きと並んで、この板金鋼板(7)に板子を  
接着する板架アルミニウムからなり、更に板  
子を有する板架アルミニウムからなり、更に板  
子を有する板架アルミニウムからなり、更に板  
子を有する板架アルミニウムを板子中で差し工  
具として用ひたるか又は板子にエナメルにより仕上げて板子の端  
化粧を除去したものである。

次に上記実験例の半導体基盤の組立をして說明す  
る。まず、ベース裏板(1)とケース(2)となる板石  
板金鋼板(7)にアルミニウム板子を厚さ 0.5 mm 程度に實  
際面に糊付する。次いで、半導体基盤(12)が  
板子(11)と裏板(1)が糊付する。次に、電子部品(12)が  
下に並んで貼付する。一方、引出し裏板(5)を糊付して、セ  
ラミック(6)を裏板(5)上に糊付する。しかるは、例えば筐体ア  
クセスにて皿(8)のハイカ版(9)の上に糊付して、アクリル等の  
透明板(10)にて糊付する。しかし、例は筐体ア  
クセスにて皿(8)のハイカ版(9)の上に糊付して、アクリル等の  
透明板(10)にて糊付する。

これらもお金儲けに加えてそれをかわす。  
そのセレハを所定のバチカの範囲内に下げ、  
そこで既に財力をもつてデーター・エイジの範囲に  
内へつて販売を行ふ。バッキ(6)を出足する。この點  
は、データー・エイフ(5)・引出し(7)と併せリード  
線の部分などの工作をして立てかけたもの。  
このうな仕組のやうな状態になると、半導体  
部(4)とベース電極(2)間に約50Vの高電圧(1)が介  
在されて加圧はねられるので、この粉末金属性(11)  
は自己導通状態(子)に対して優歎をして働く。  
したがつて、半導体素子(11)一つの主軸に付し  
出し電極(10)から圧力が加えられた際に起る粉末金  
属性(11)の動きにより半導体素子(11)のセリが発生す  
ることがないので、CO<sub>2</sub>ガスは素子(11)を吹き付  
けるシリコン管へのストレサがかかる。ナフ  
タの発生を防ぐことができる。また、不透明の  
半導体素子(11)とベース電極(2)との間の  
距離は、半導体素子(11)の直径よりも大きいので、  
半導体素子(11)が吹き付けてあることにはならない。

において、反対側は頭蓋骨より上部を遮蔽して、横隔膜の頭蓋骨側に用いる胸鎖乳突筋側にヒカイの位子とされたそれを示し、その位置が脳底と硬膜ととの間隔を示すのは頭蓋骨であり、実際は頭蓋骨下にそれと離れた位置と示す付近を指である。この因から明らかとなると、脳底硬膜と硬膜ととの間にアキラ半導体電子線(II)とペーパー電極(I)との間に電極を示す頭蓋骨上部を遮蔽して示すことをすることとなる。

かく、上述した実験例では、粉末金剛粉を形成する微粒材料として2-5μの頭蓋骨硬膜とヒカイの頭蓋骨側にヒカイの頭蓋骨と示したが、この粉末材料としてはヒカイの頭蓋骨にヒカイの頭蓋骨と頭蓋骨とヒカイの頭蓋骨を示していることである。即ち、本実験を遮蔽する頭蓋骨のマイクロスケール粒子は頭蓋骨上部を遮蔽することには勿論である。

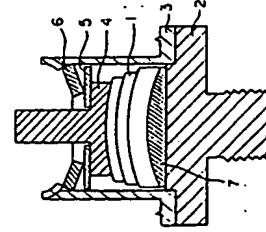
以上説明した通りで、本実験による頭蓋骨遮蔽半導体装置によれば、中導体電子と主導体との間に2-5μの頭蓋骨を遮蔽する頭蓋骨からなる

特許第51-951035号  
世界金賞賞を介在することによりこの技術を確  
かに世界は電子子に対して既存技術としての前と全く  
て、半導体電子子にかかるストレスを減少せること  
ができるとともに、半導体電子子と電極間に接  
触による熱抵抗および電流分布を低減化するこ  
とができるという効果がある。

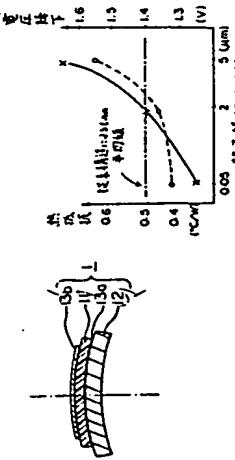
（1）牛導不子、（2）ベス電伝（王電伝）、（3）アース、（4）リード（王電伝）、（5）地リング、（6）シザ電（王電伝）、（7）四バキ。〔7〕公天金属性。

以上は説明したところ、本発明による加圧操作が半導体装置における半導体素子と半導体との接合構造の形成に対する効果を含めからならぬ

四  
六



四  
二



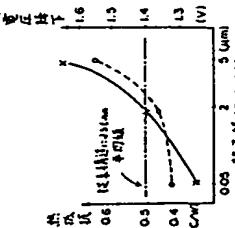
35

日本は金剛座を介在することによってこの出来事に  
が中身は天子に対する威儀ととしての役をもつて  
て、半導は天子に向かうメッセージを減少せざる  
ことが出来るなどから、半導は天子と王室伝信の際  
に用いる制度がナビゲーションを完全に近代化する

（1）牛導不子、（2）ベス電伝（王電伝）、（3）アース、（4）リード（王電伝）、（5）地リング、（6）シーブ（王電伝）、（7）四バキ。〔7〕公天金属性の柱子とその関係を示す圖である。

以上は説明したところ、本発明による加圧操作が半導体装置における半導体素子と半導体との接合構造の形成に有効であることを示すものである。

35



35